2023年度　工学部セメスター派遣プログラム　申請書

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| フリガナ | (セイ) | (メイ) | 写真 |
| 氏名 | ( 姓 ) | ( 名 ) |
| 氏名(ローマ字) | (※パスポートの表記又はパスポート申請予定の表記と同様) |
| 住所 | 〒　　　-　　　　　 |  |
| 所属 | 工学部 | 学科 | 年 | 学籍番号 | 教員名（自署） |
| 連絡先 | 携帯電話：E-mail（大学付与メールアドレス）： |
| 出身高校 |  |
| 語学力 | ※証明書添付のことTOEFL(iBT・PBT・ITP)・TOEIC・IELTS・英検 点・級※いずれかに○をしてください。 ( 年 月 日時点) |
| 希望順位等 |

|  |  |
| --- | --- |
| 　　　　　　　　大学名　　　　 | 希望インターンシップ先企業（TUMは除く）2社 |
| 第一希望 |  |
| 第二希望 |  |
| 第三希望 |  |

 |
| 希望する研究テーマ | キーワードのみ： |
| 国籍\* | (外国籍の場合、永住許可：有・無) |
| 奨学金受給状況 | 現在受給している奨学金：　有・無（有を選択した場合）　奨学金名称：　　　　　　　　　　　　　　併給：　可・否　　　月額　　　　　　円 |
| 保護者の同意 | 上記申請者が、東京農工大学セメスター派遣プログラムに参加することに同意します。年　　　月　　　日　　　　　　　保護者氏名： (自署) |

\*奨学金要件確認、ビザ要件確認のため使用

◆留学プロポーザル◆

|  |
| --- |
| ●志望動機●自己PR●将来の計画、グローバル活動への抱負等●派遣先大学で行いたい研究、学びたいこと等研究キーワード（英語で）＞●希望するインターンシップ先企業・団体へどのようにアプローチしていくか　（希望する国ごとに記載） |

**◆締　切：2023年1月27日(金)16:30厳守**

◆提出先：工学部　学生支援室　教務係　[窓口持参]または[郵送]により提出